2026/11/06

ABF 載板　　重新覆蓋

欣興 (3037 TT)　　買進(Buy)

欣興向榮，ABF 漲價啟動

- **規格與出貨同步升級，2027 年 ABF 漲幅上看 30%**
- **新廠逐年開出，ABF 產能年增逾三成**
- **切入 Intel EMIB 平台，帶動 ABF 載板單位價值提升**

3Q26 營收創高，BT 轉產暫壓獲利：欣興 3Q26 營收 526.5 億元(QoQ+22.8%)，毛利率 28.9%(QoQ+4.1ppts)，稅後淨利 100.5 億元，EPS 6.36 元。整體獲利低於市場預期，主因有兩個。(1)台灣 BT 廠區逐步轉換至 ABF，部分產線停工，稼動率較 2Q26 下滑，導致 BT 毛利率僅低個位數；3Q26 又調整員工分紅比例，影響毛利率約 1.2ppts。(2)2Q26 業外認列較多金融資產評價利益，墊高獲利基期，3Q26 稅後淨利 QoQ-23.4%。展望 4Q26，由於上游原料持續維持緊缺格局，預期 BT 報價將續漲中個位數，ABF 報價 QoQ+10%，ABF 毛利率則往 50%以上看待。預估 4Q26 營收達 655.4 億元(QoQ+24.5%, YoY+88.9%)，毛利率 32.7%(QoQ+3.9ppts)，EPS 8.36 元。

規格與出貨同步升級，2027 年 ABF 缺口擴大：欣興為目前 AI GPU/ASIC 主要的載板供應商，2H26 高階 ABF 已占 ABF 營收 70%以上。展望 2027 年，NVIDIA Rubin、Google TPU v8 等大型 GPU/ASIC 方案放量，出貨顆數上升，封裝層數與面積亦持續提高。以 NVIDIA 為例，載板層數由 B200 的 16~20L 提升至 Rubin 的 18~24L，尺寸放大至 100x100mm，ASP 提升 2~3 倍。我們預估在出貨量與規格同步提升下，2027 年 ABF 載板供需缺口將擴大至 30%以上；加上 T-glass 等關鍵原料 2027 年仍供不應求，預期欣興 2027 年 ABF 全年漲幅可達 30%，推升 ABF 全年平均毛利率至 50%以上。

漲價與擴產並進，獲利成長明確：2027 年需求將帶動 ABF 漲價循環，我們預期載板廠將開始把產能緊缺反映在報價上，毛利擴張速度將顯著優於 2026 年。欣興 2027~2028 年產能開出進度明確，並以客戶預付款支應擴產資金，考慮擴產以及 BT 產能逐漸轉往 ABF，預估欣興 2026~2028 年 ABF 產能將分別成長 37.2%/36%/36%。我們對公司後續成長保持樂觀。預估欣興 2026~2028 年 EPS 分別為 26.35/52.61/86.97 元；以 2027 年 EPS 及 25 倍本益比推估目標價為 1,315 元，建議買進。

風險因子：AI 晶片需求放緩、EMIB 良率不如預期、漲價受限 LTA。

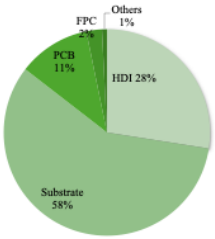
臺灣 ESG 永續指數成分股

潛在漲幅	64.38%
前日收盤價	800.00 元
目標價	1,315.00 元
前次目標價	-
前次評等	-

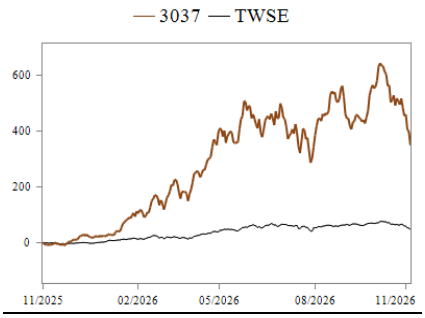
公司基本資訊

目前股本(百萬元)	16,440
市值(億元)	13,152
目前每股淨值(元)	108.24
外資持股比(%)	40.27
董監持股比(%)	13.88

營業比重(2025 年)



個股與大盤走勢(%)

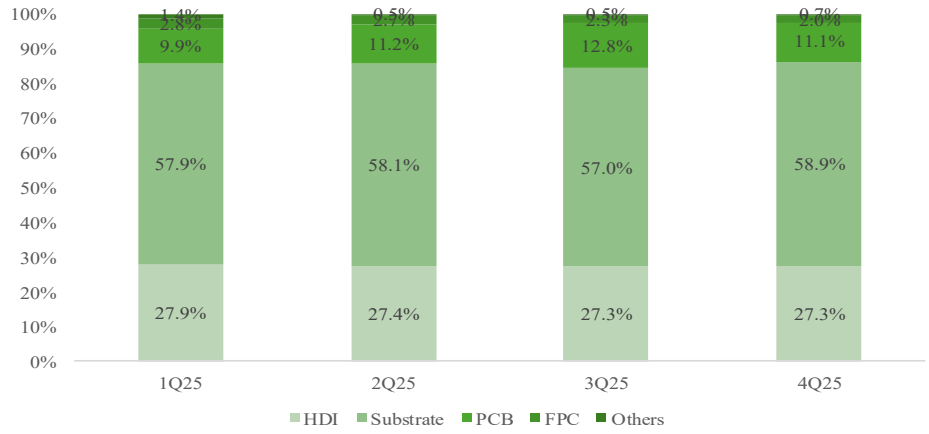


王翊安
wade.wang@ctbcsis.com

(百萬元)	2023	2024	2025	2026F	2027F	2028F
營業收入淨額	104,036	115,373	131,241	198,530	341,806	471,102
營業毛利淨額	20,302	16,315	18,292	54,001	128,974	205,430
營業利益	8,920	5,117	6,674	35,681	101,197	170,121
稅後純益	11,980	5,082	6,673	41,954	86,486	142,981
公告基本 EPS(元)	7.88	3.34	4.38	--	--	--
調整後 EPS(元)	7.86	3.33	4.24	26.35	52.61	86.97
營業收入 YoY(%)	-25.95%	10.90%	13.75%	51.27%	72.17%	37.83%
稅後純益 YoY(%)	-59.55%	-57.58%	31.31%	528.70%	106.15%	65.32%
本益比	21.64	41.61	50.13	31.35	15.21	9.20
本淨比	2.87	2.27	3.44	9.43	6.29	4.14
股息(元)	3.00	1.50	1.98	1.95	10.21	21.04
殖利率(%)	1.71%	1.22%	0.20%	0.24%	1.28%	2.63%
ROE(%)	13.58%	5.53%	6.89%	34.96%	49.63%	54.30%

公司簡介：欣興成立於 1990 年，為聯電集團旗下的 PCB 與 IC 載板廠。公司生產基地以台灣為主，並於中國、日本、德國設有據點，泰國廠為 HDI 新產能；近年陸續處分效益不佳的海外子公司，資源集中於台灣 ABF 擴產。產品線涵蓋 IC 載板、HDI、PCB 及 FPC，3Q26 載板營收占比達 62%(其中 ABF 占 55%)，HDI 及 PCB 分別占 27%及 9%。欣興為全球最大 IC 載板廠，高階 ABF 載板供應僅次於 Ibiden，具備載板、HDI 至 PCB 的完整製程能力；截至 2026 年 3 月底，集團員工約 31,000 人。

圖表一、欣興營收產品組合趨勢



資料來源：Bloomberg、中信投顧整理

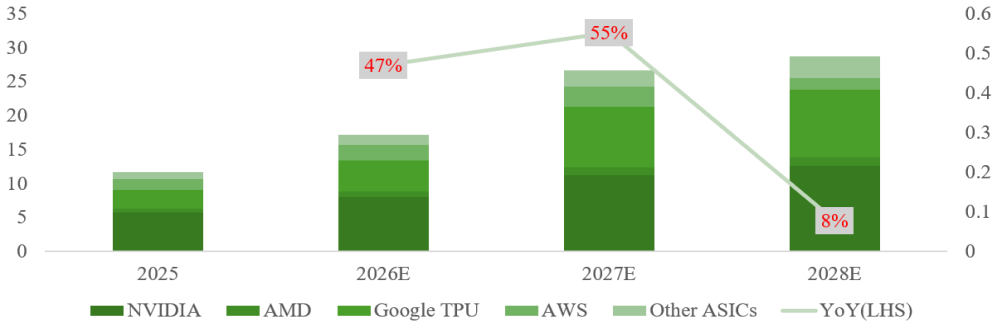
GPU/ASIC 出貨顆數大幅成長：2H26~1H27 是各大 GPU/ASIC 廠商推出新專案的階段，2027 年整體出貨量將較 2026 年顯著提升。我們預估 2027 年 NVIDIA GPU、Google TPU 及 AWS Trainium 出貨量將分別達 800 萬、900 萬及 300 萬顆以上，帶動整體 GPU/ASIC 出貨量 YoY+55%。即使不考慮規格升級，單看出貨顆數成長，亦將推升 ABF 載板需求。

圖表二、主要 GPU/ASIC/Switch 產品出貨時程

Product	4Q25	1Q26	2Q26	3Q26	4Q26	1Q27	2Q27	3Q27	4Q27
Server		Google TPU v7 AWS Trainium 2e	Nvidia Rubin MSFT Maia 200	Vera Rubin AWS Trainium 3	AMD MI450X OpenAI v1 Google TPU v8i PCIe 6.0	Google TPU v8t Meta MTIA 3 MSFT Maia 300		Rubin Ultra	AMD MI500 AWS Trainium 4
Switch	Cisco 800G / Juniper 800G Arista 800G / Meta 800G Google 800G / Nvidia 800G	Juniper 1.6T		Nvidia 1.6T / Meta 1.6T Google 1.6T / Arista 1.6T					

資料來源：中信投顧整理

圖表三、主要 GPU/ASIC 預計出貨顆數(單位:百萬顆)



資料來源：中信投顧整理

封裝規格提升帶動載板用量增加：除出貨量成長外，新產品的規格升級將進一步增加 ABF 載板用量。以 NVIDIA GPU 為例，載板尺寸由 Hopper 世代的 55x55mm 放大至 Rubin Ultra 的 120x120mm 以上，層數亦由 12L 增加至 24~30L。在不考慮良率的情況下，單顆晶片的 ABF 消耗量增加約 10~12 倍，單顆 content value 亦提升 4 倍以上。ASIC 亦呈現相同的規格升級趨勢。我們根據晶片出貨顆數及單顆晶片所需 ABF 面積的成長推估，2027 年 ABF 供需缺口將擴大至 30%以上，帶動 2027 年 ABF 漲幅上看 30%。

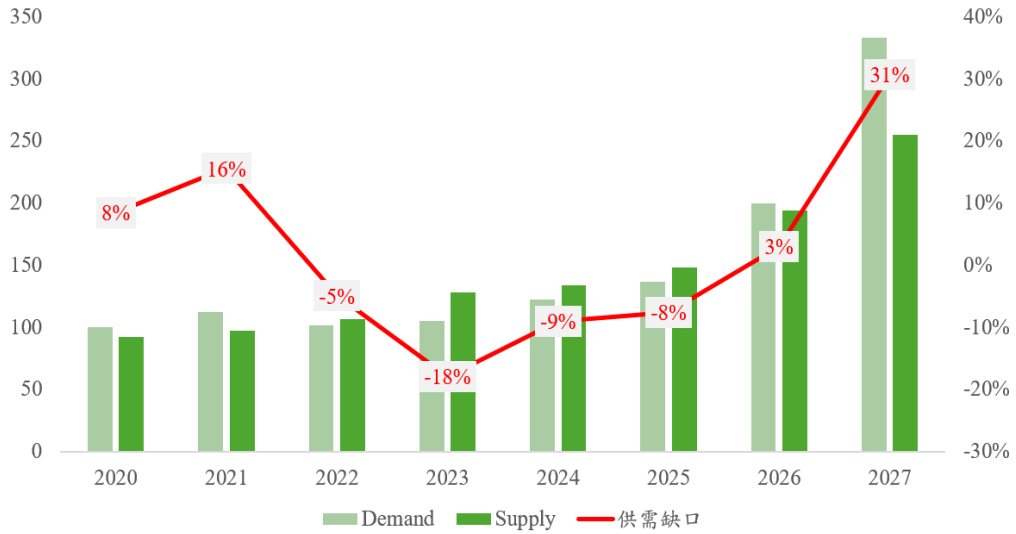
ABF 將是欣興未來兩年的成長主軸。我們預估欣興 2027/2028 年 ABF 營收占比將達 62.6%/72.1%；在漲價、良率穩定及稼動率滿載下，預估 2027/2028 年 ABF 毛利率將達 51.3%/54.4%，符合公司 ABF 毛利率 50%以上、長期上看 60%的指引。

圖表四、主流 GPU/ASIC 世代載板規格

Category	Platform	Vendor	尺寸	層數
GPU	H200	NVIDIA	55x55mm	12L
GPU	B200	NVIDIA	75x85mm	16~20L
GPU	B300	NVIDIA	75x85mm	16~20L
GPU	Rubin	NVIDIA	95x95~100x100mm	18~24L
GPU	Rubin Ultra	NVIDIA	120x120+mm	24~30L
GPU	MI300	AMD	60x60mm	12L
GPU	MI325	AMD	60x61mm	12L
GPU	MI350	AMD	95x95mm	22~24L
GPU	MI450	AMD	110x110mm	26~28L
ASIC	TPU v5e	Google	60x60~70x70mm	12L
ASIC	TPU v5p	Google	60x60~70x70mm	12L
ASIC	TPU v6	Google	70x70~80x80mm	12~16L
ASIC	TPU v7	Google	80x80~90x90mm	14~18L
ASIC	TPU v8i	Google	100x100mm	18~22L
ASIC	TPU v8t	Google	100x100mm	18~22L
ASIC	Trainium 2	AWS	80x80mm	16~18L
ASIC	Trainium 2.5	AWS	80x80mm	16~18L
ASIC	Trainium 3	AWS	80x80mm	16~18L
ASIC	Trainium 4	AWS	90x90~100x100mm	18~24L
ASIC	Maia M300	Microsoft	105x105mm	24L
ASIC	MTIA3	Meta	100x100mm	24L

資料來源：中信投顧整理

圖表五、ABF 載板供需缺口預估(以 2020 需求=100 開始計算)



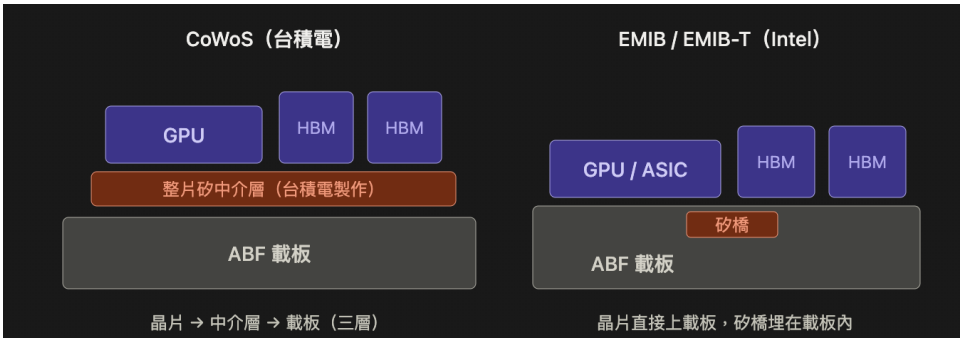
資料來源：中信投顧整理

BT 漲價邏輯在於產能排擠：過去市場認為 BT 漲價力道不如 ABF，主因在於消費性需求疲弱。2026 年消費性需求雖仍疲弱，但記憶體需求強勁，填補了消費性的缺口。供給面來看，BT 過去幾年表現疲弱，大廠不敢大幅擴產；加上欣興等大廠將產能逐步分配給利潤更好的 ABF 載板，自 2026 年起逐步減產 BT、將產能移轉至 ABF。然而產能移轉期間，欣興 BT 毛利率持續受到壓抑，3Q26 BT 毛利率僅低個位數。

此外，上游 T-glass 供應仍然緊缺。根據供應鏈調查，T-glass 目前約 70%需求來自 ABF 載板、30%來自 BT；供給端 Nittobo 約占 40%，其餘 60%由台灣及中國廠商供應。Nittobo 雖於 2027 年陸續開出 T-glass 新產能，但增幅有限，加上 2027 年 ABF 需求大幅成長，我們預期供需缺口將延續至 2028 年。因此，即使 BT 需求成長幅度不及 ABF，在(1)產能排擠及(2)上游原料供給緊缺未解下，我們預估 BT 2027 年仍有 15~20%的漲幅。

欣興將為 EMIB 主要載板供應商之一：CoWoS 與 EMIB 皆為將運算晶片與 HBM 整合於同一封裝內的 2.5D 先進封裝技術。兩者差異在於，CoWoS 為「晶片→中介層→載板」的三層結構：晶片先置於台積電製作的中介層(interposer)上，晶片間的細線路全部由中介層完成，再將中介層置於 ABF 載板上。此架構下，載板僅負責承接中介層，並將訊號與電力傳導至 PCB，屬被動承載角色。EMIB 則移除中介層，晶片直接置於載板上，僅在兩顆晶片交界下方的載板增層中埋入小塊矽橋(Silicon Bridge)完成高密度互連；EMIB-T 再於矽橋中加入矽穿孔(TSV)，使電力與訊號可垂直穿過矽橋，以支援更大尺寸封裝與 HBM4。由於不需大面積中介層，EMIB 封裝尺寸不受中介層面積限制，成本較低，但互連僅發生於晶片邊緣，頻寬不及整片中介層。

圖表六、EMIB 平台對比 CoWoS 示意圖

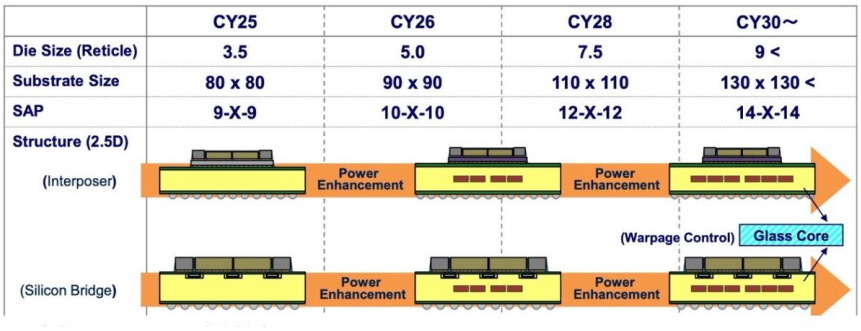


資料來源：中信投顧整理

對載板廠而言，EMIB 的 content value 較高，原因在於原本由中介層承擔的部分功能移轉至載板端，載板廠須在增層中挖槽、精準對位埋入矽橋，並於大尺寸下維持平整度與翹曲控制，等同將部分封裝工序內化至載板製程中，故欣興於 EMIB 平台的單價較 CoWoS 更高。

但良率仍為主要瓶頸之一，目前欣興 EMIB 載板良率目標為 50%；EMIB-T 因內埋設計更多，製程難度更高，預計 2027 年開始初步試產，設備大量移入(move-in)時程則視第一階段試產的良率表現而定。供應商方面，目前 EMIB 載板供應商含欣興約 5 家，EMIB-T 約 3 家。欣興預計於楊梅廠配置約 10~15%產能支援 EMIB 載板生產，良率與日系同業相當。

圖表七、Ibiden 載板 Roadmap



資料來源：Ibiden

目前預計導入 EMIB 設計的專案以 Google TPU v9 為主，其 reticle size 達 9 倍。在出貨量龐大、EMIB 良率仍低的情況下，預期將大量消耗載板產能，以初期良率 50%估算，代表一半的產能與材料在製程中耗損，有效產出偏低。綜合上述因素，我們預期高階 ABF 載板缺貨將持續兩年以上，成為推升載板供不應求與漲價的因素之一。加上 EMIB 的 content value 較高，即使 EMIB 短期內對欣興獲利的直接貢獻有限，仍有助於推升欣興 ABF 平均單價。

新廠逐年開出，ABF 產能年增逾三成：產能方面，欣興規劃每年新增一座 ABF 廠區。光復二廠分三期開出，2Q27 開出一期、2H27 開出二期，三期最快 2027 年底開出；楊梅二廠預計 2028 年底開出，楊梅三廠已動工，預計 2029 年量產。以每座新廠初期月產能約 7,000 片為基準，每增加一座廠區可貢獻約 30~40%產能，且楊梅二、三廠規模將大於光復一、二廠。資本支出方面，公司將 2026 年資本支出由 197 億元上修至 537 億元，10 月董事會再追加 509 億元長交期設備採購，對應 2027~2028 年產能建置。客戶預付款已足以支應未來兩年擴產所需，加上台灣廠區 BT 產能逐步轉作 ABF，我們預估欣興 2026/2027/2028 年 ABF 產能將分別成長 37.2%/36%/36%。

整體而言，欣興在本波 ABF 載板漲價循環中具備足夠的擴產幅度，並於 AI GPU/ASIC ABF 載板市場握有主要份額，我們預估欣興 2026/2027/2028 年 EPS 分別為 26.58/52.61/86.97 元。此外，欣興為台系載板廠中投入 EMIB、玻璃載板等新技術最積極的廠商，有助於鞏固中長期競爭地位。以 2027 年 EPS 及 25 倍本益比推估目標價為 1,315 元，建議買進。

圖表八、季度財報與預估差異

損益表	3Q26					4Q26(F)				
(單位：百萬元)	實際數	中信預估	差異	市場共識	差異	調整後	調整前	差異	市場共識	差異
營業收入	52,650	-	-	50,366	4.5%	65,544	-	-	59,135	10.8%
營業毛利	15,189	-	-	14,044	8.2%	21,447	-	-	19,348	10.9%
營業利益	10,528	-	-	9,878	6.6%	15,745	-	-	14,544	8.3%
稅前純益	13,163	-	-	8,577	53.5%	17,711	-	-	15,104	17.3%
稅後淨利	10,052	-	-	6,738	49.2%	13,744	-	-	11,913	15.4%
EPS(元)	6.14	-	-	4.14	48.4%	8.36	-	-	7.12	17.5%
財務比率(%/百分點)										
毛利率	28.8%	-	-	27.9%	1.0 ppts	32.7%	-	-	32.7%	0.0 ppts
營益率	20.0%	-	-	19.6%	0.4 ppts	24.0%	-	-	24.6%	-0.6 ppts
稅後淨利率	19.1%	-	-	13.4%	5.7 ppts	21.0%	-	-	20.1%	0.8 ppts

資料來源：Cmoney、Bloomberg，中信投顧整理

圖表九、年度財報與預估差異

損益表	2026(F)					2027(F)				
(單位：百萬元)	調整後	調整前	差異	市場共識	差異	調整後	調整前	差異	市場共識	差異
營業收入	198,530	-	-	190,816	4.0%	341,806	-	-	296,133	15.4%
營業毛利	54,001	-	-	51,967	3.9%	128,974	-	-	115,089	12.1%
營業利益	35,681	-	-	34,119	4.6%	101,197	-	-	90,304	12.1%
稅前純益	52,749	-	-	48,321	9.2%	111,452	-	-	93,508	19.2%
稅後淨利	41,954	-	-	38,736	8.3%	86,486	-	-	73,200	18.2%
EPS(元)	26.23	-	-	24.44	7.4%	52.61	-	-	45.56	15.5%
財務比率(%/百分點)										
毛利率	27.2%	-	-	27.2%	0.0 ppts	37.7%	-	-	38.9%	-1.1 ppts
營益率	18.0%	-	-	17.9%	0.1 ppts	29.6%	-	-	30.5%	-0.9 ppts
稅後淨利率	21.1%	-	-	20.3%	0.8 ppts	25.3%	-	-	24.7%	0.6 ppts

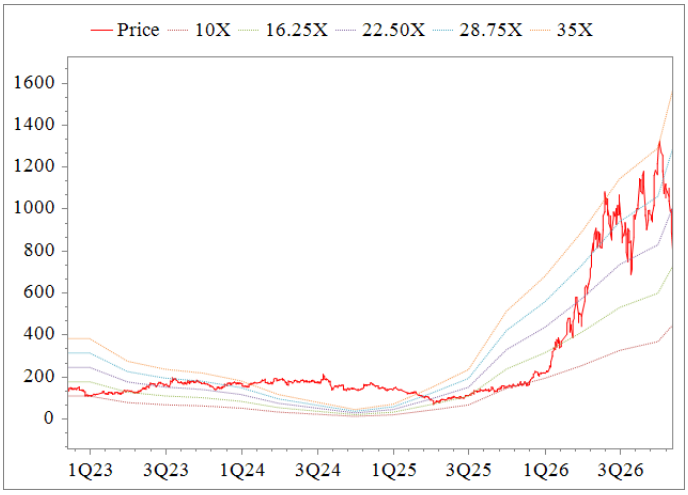
資料來源：Cmoney、Bloomberg，中信投顧整理

2026/11/06

(百萬元)	1Q26	2Q26	3Q26	4Q26F	1Q27F	2Q27F	3Q27F	4Q27F
營業收入	37,446	42,890	52,650	65,544	73,185	81,587	89,579	97,455
營業成本	30,720	32,252	37,460	44,097	47,410	51,607	55,306	58,509
營業毛利	6,726	10,638	15,189	21,447	25,774	29,980	34,273	38,946
營業費用	3,993	4,006	4,680	5,702	6,221	6,690	7,166	7,699
營業利益	2,757	6,651	10,528	15,745	19,554	23,290	27,107	31,247
營業外收支淨額	3,542	8,925	2,636	1,966	2,196	2,448	2,687	2,924
稅前純益	6,299	15,576	13,163	17,711	21,749	25,738	29,794	34,171
所得稅	918	2,233	2,743	3,542	4,350	5,148	5,959	6,834
稅後純益	5,043	13,115	10,052	13,744	16,877	19,973	23,120	26,516
調整後 EPS(元)	3.28/	8.45	6.36	8.36	10.27	12.15	14.06	16.13
毛利率(%)	17.96%	24.80%	28.85%	32.72%	35.22%	36.75%	38.26%	39.96%
營業利益率(%)	7.36%	15.51%	20.00%	24.02%	26.72%	28.55%	30.26%	32.06%
稅後純益率(%)	13.47%	30.58%	19.09%	20.97%	23.06%	24.48%	25.81%	27.21%
營業收入								
QoQ(%)	7.94%	14.54%	22.76%	24.49%	11.66%	11.48%	9.80%	8.79%
YoY(%)	24.45%	32.11%	54.88%	88.94%	95.44%	90.23%	70.14%	48.69%
營業利益								
QoQ(%)	16.53%	141.28%	58.28%	49.56%	24.19%	19.11%	16.39%	15.27%
YoY(%)	117.60%	340.66%	586.94%	565.57%	609.33%	250.17%	157.48%	98.46%
稅後純益								
QoQ(%)	42.68%	160.06%	-23.36%	36.73%	22.80%	18.34%	15.76%	14.69%
YoY(%)	451.42%	44,196.75%	358.05%	288.85%	234.67%	52.29%	130.01%	92.93%

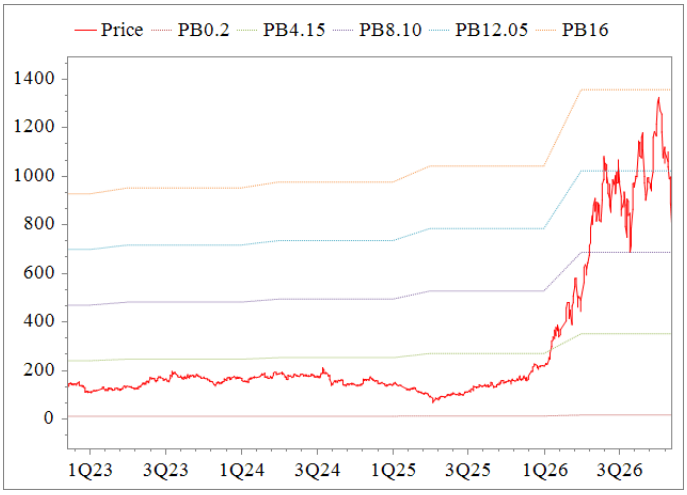
*調整後 EPS 為根據調整後加權平均股數計算

PER Band



資料來源：中信、CMoney

PBR Band



資料來源：CMoney

資產負債表

(百萬元)	2022	2023	2024	2025	3Q26
資產總計	218,663	216,006	230,847	255,792	399,844
流動資產	107,588	86,579	86,869	105,298	232,945
現金及約當現金	61,459	52,859	43,753	54,872	159,694
應收帳款與票據	28,746	18,563	23,612	27,565	38,786
存貨	12,835	10,927	14,863	17,802	24,876
採權益法之投資	2,534	949	911	836	971
不動產、廠房設備	94,122	109,483	120,536	125,866	130,199
負債總計	126,005	119,721	131,260	148,785	217,774
流動負債	54,893	44,247	58,382	75,455	95,939
應付帳款及票據	11,434	11,084	14,834	17,118	21,048
非流動負債	71,113	75,474	72,878	73,330	121,835
權益總計	92,658	96,284	99,587	107,007	182,071
普通股股本	14,784	15,251	15,300	15,296	16,439
保留盈餘	61,632	61,518	61,917	66,377	91,483
母公司業主權益	85,735	90,661	93,265	100,569	177,833
負債及權益總計	218,663	216,006	230,847	255,792	399,844

損益表

(百萬元)	2024	2025	2026F	2027F	2028F
營業收入淨額	115,373	131,241	198,530	341,806	471,102
營業成本	99,058	112,949	144,529	212,833	265,672
營業毛利淨額	16,315	18,292	54,001	128,974	205,430
營業費用	11,265	11,782	18,382	27,776	35,309
營業利益	5,117	6,674	35,681	101,197	170,121
EBITDA	23,955	27,268	72,500	134,488	209,697
業外收入及支出	2,204	2,153	17,069	10,254	14,133
稅前純益	7,321	8,827	52,749	111,452	184,254
所得稅	1,765	1,277	9,437	22,290	36,851
稅後純益	5,082	6,673	41,954	86,486	142,981
公告基本 EPS(元)	3.34	4.38	- -	- -	- -
調整後 EPS(元)	3.33	4.24	26.35	52.61	86.97

註：稅後純益係指本期淨利歸屬於母公司業主。

現金流量表

(百萬元)	2022	2023	2024	2025	3Q26
營業活動現金	61,082	30,900	10,294	14,967	11,799
稅前純益	39,875	15,575	7,321	8,827	13,163
折舊及攤銷	11,727	15,097	17,231	18,773	5,200
營運資金變動	-7,658	11,749	-5,154	-4,514	-7,536
其他營運現金	17,138	-11,521	-9,104	-8,118	972
投資活動現金	-33,396	-21,099	-29,230	-23,018	-10,685
資本支出淨額	-31,025	-22,755	-25,735	-25,274	-8,040
長期投資變動	-2,003	-1,523	-3,050	1,622	-170
其他投資現金	-368	3,179	-445	635	-2,475
籌資活動現金	-4,831	-18,060	8,336	19,073	65,198
長借/公司債變動	1,757	-898	8,388	9,950	624
現金增資	0	0	0	1,707	43,246
發放現金股利	-5,016	-12,190	-4,575	-2,295	0
其他籌資現金	-1,573	-4,971	4,524	9,711	21,328
淨現金流量	22,058	-8,600	-9,106	11,118	66,434
期初現金	39,402	61,459	52,859	43,753	93,973
期末現金	61,459	52,859	43,753	54,872	160,406

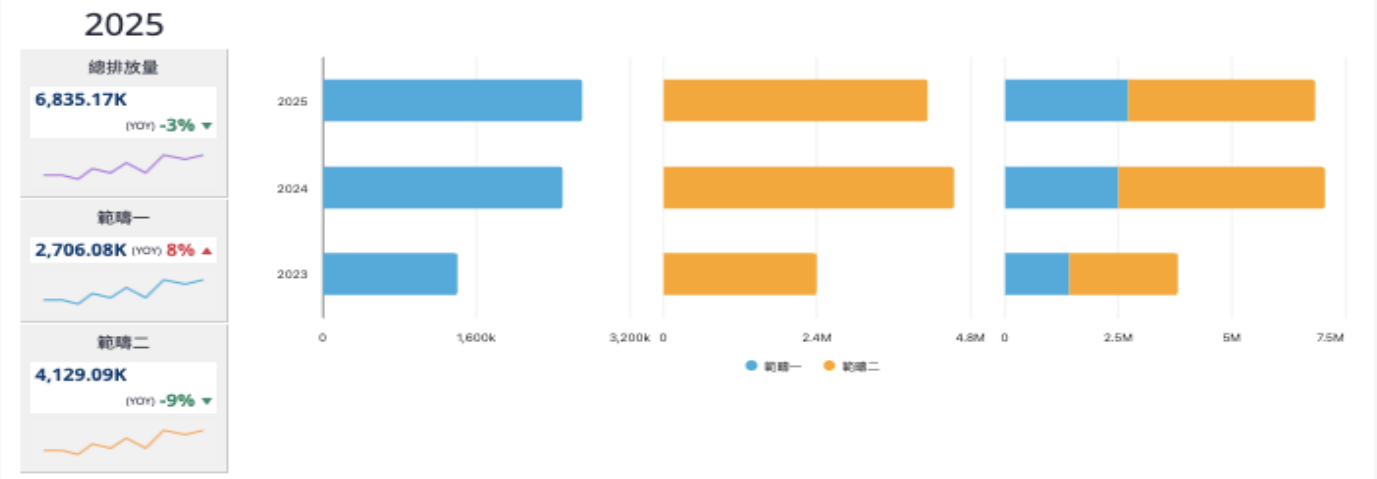
資料來源：中信、CMoney

比率分析

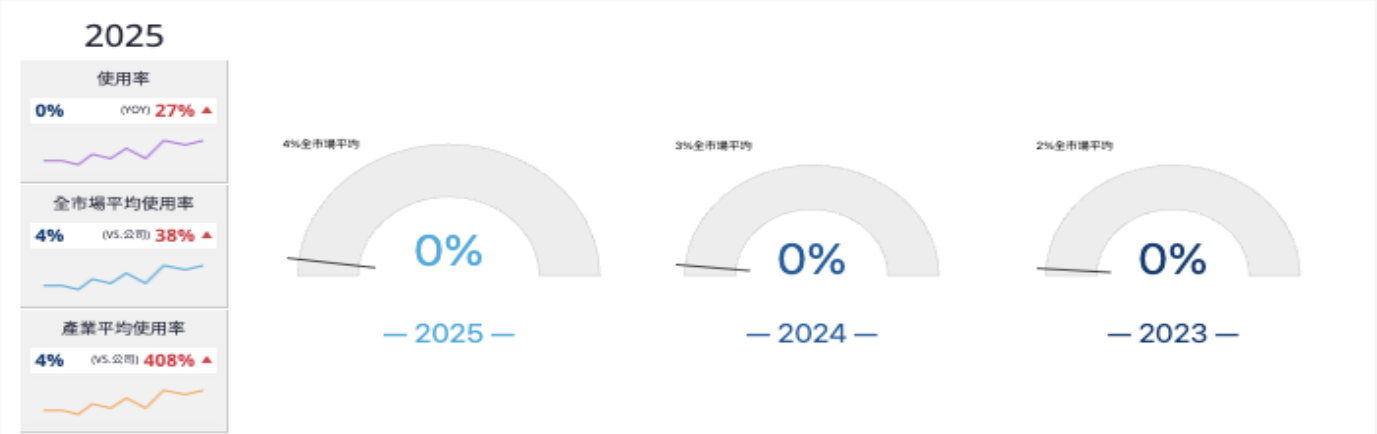
(百萬元)	2024	2025	2026F	2027F	2028F
成長力分析(%)					
營業收入淨額	10.90%	13.75%	51.27%	72.17%	37.83%
營業毛利淨額	-19.64%	12.12%	195.21%	138.84%	59.28%
營業利益	-42.64%	30.44%	434.59%	183.62%	68.11%
稅後純益	-54.55%	35.90%	528.70%	106.15%	65.32%
獲利能力分析(%)					
毛利率	14.14%	13.94%	27.20%	37.73%	43.61%
EBITDA(%)	20.76%	20.78%	36.52%	39.35%	44.51%
營益率	4.43%	5.09%	17.97%	29.61%	36.11%
稅後純益率	4.82%	5.75%	21.13%	25.30%	30.35%
ROE(%)	5.53%	6.89%	34.96%	49.63%	54.30%

ESG 資訊—環境保護(Environmental)

溫室氣體(範疇一/二)排放量



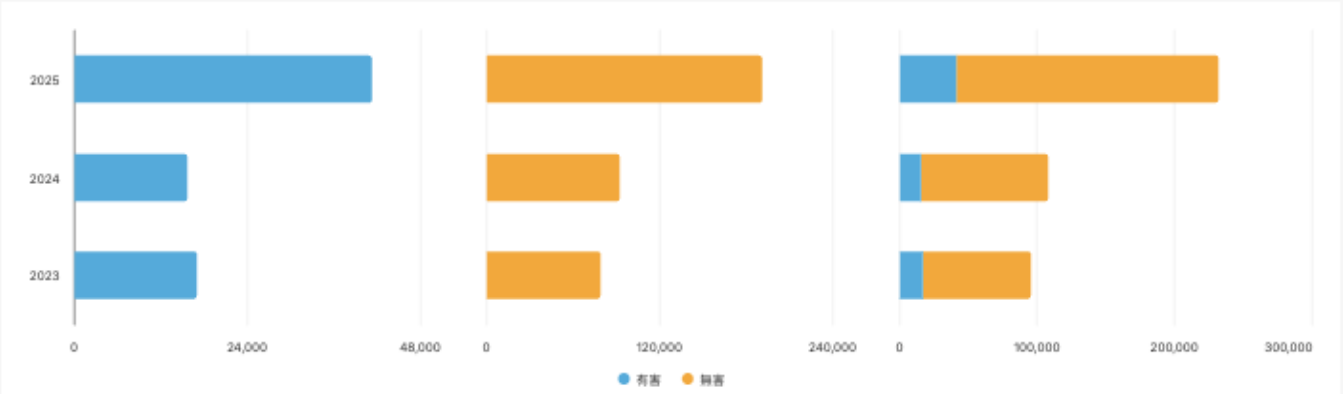
再生能源使用率



用水量



廢棄物量



2025

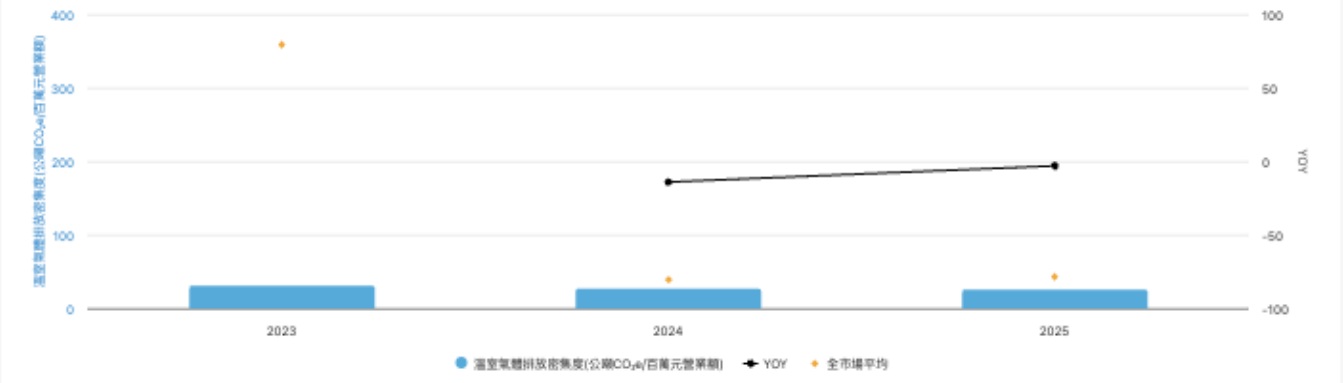
有害	無害	總量
41.26K (YOY) 162% ▲	191.02K (YOY) 106% ▲	232.29K (YOY) 106% ▲

密集度

2025

溫室氣體排放密集度	用水密集度	廢棄物密集度
26.298	113.886	0.894

溫室氣體排放密集度(公噸CO_2e/百萬元營業額)



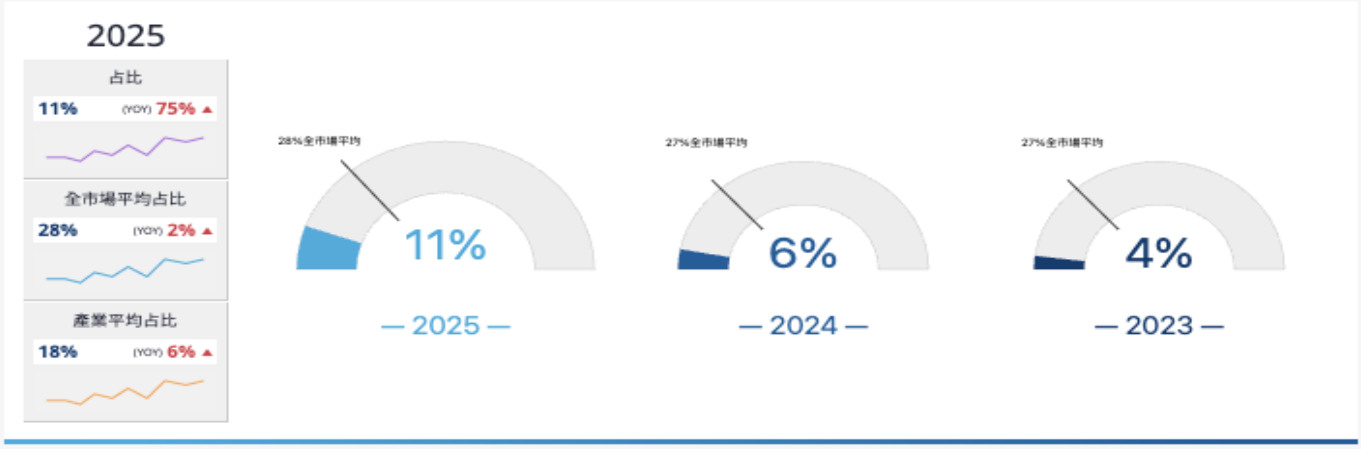
2025

溫室氣體排放密集度(公噸CO_2e/百萬元營業額)	全市場平均溫室氣體排放密集度(公噸CO_2e/百萬元營業額)	產業平均溫室氣體排放密集度(公噸CO_2e/百萬元營業額)
0.03K (YOY) -3% ▼	0.04K (YOY) 10% ▲	0.02K (YOY) -6% ▼

2026/11/06

ESG 資訊—社會責任(Social)

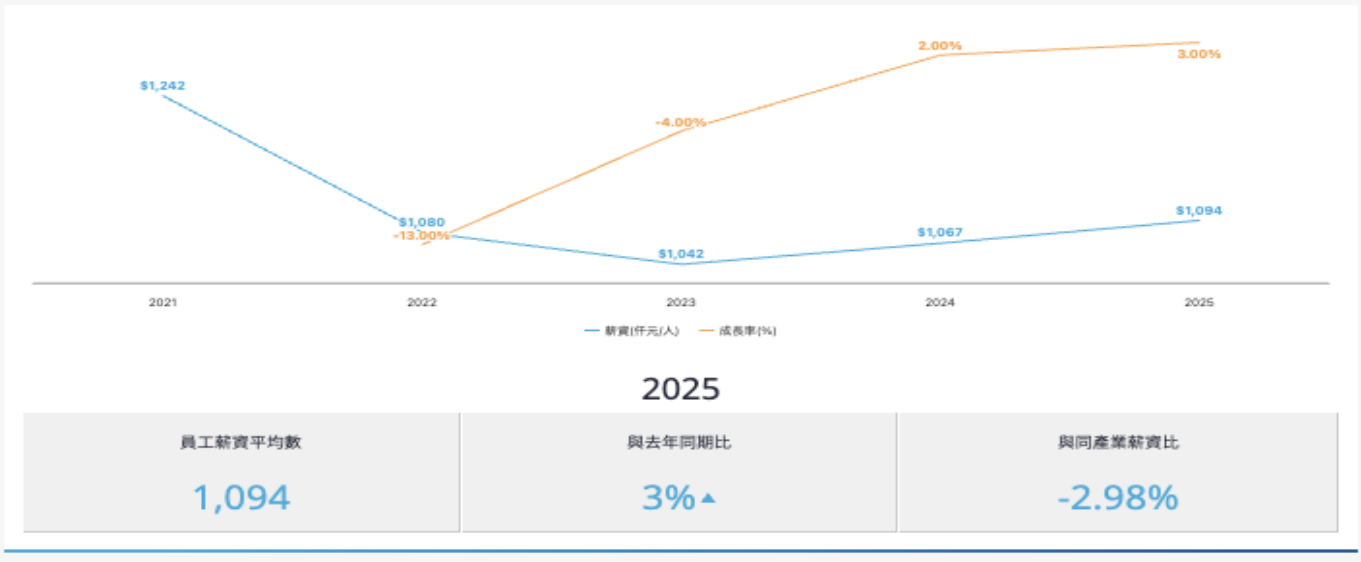
管理職女性主管占比



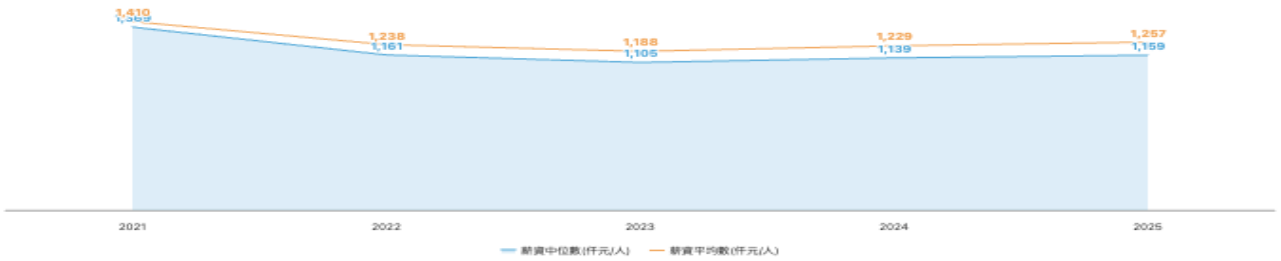
職業災害人數



員工薪資年度趨勢



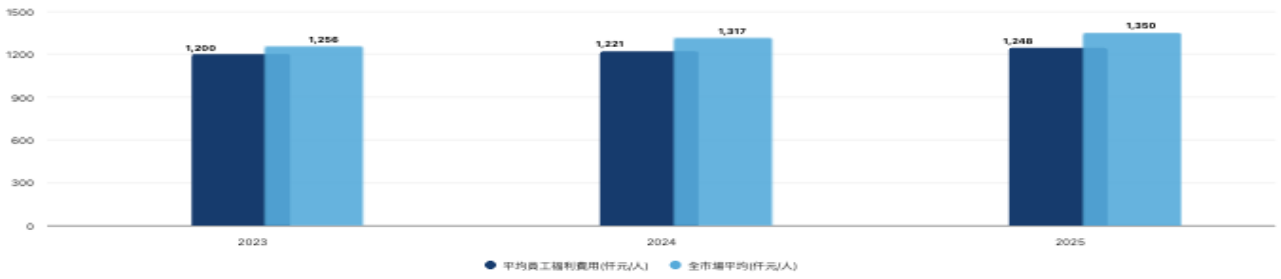
非擔任主管職務之全時員工薪資



2025

平均數	中位數	差異%
1,257 (YOY) 2% ▲	1,159 (YOY) 2% ▲	0% (YOY) 0% —

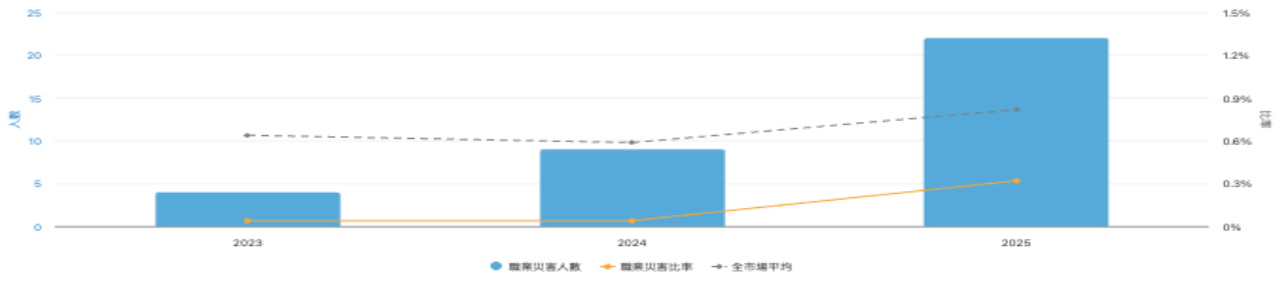
平均員工福利費用



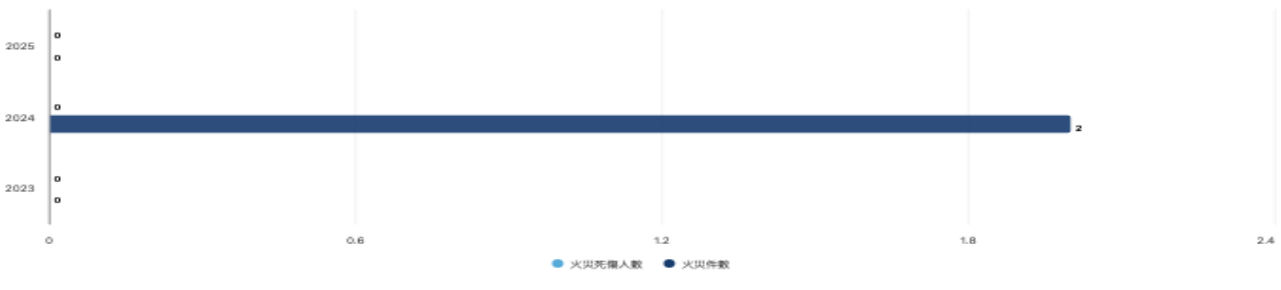
2025

平均福利	全市場平均福利	產業平均福利
1,248 (YOY) 2% ▲	1,350 (YOY) 3% ▲	1,302 (YOY) 3% ▲

職業災害人數與比率



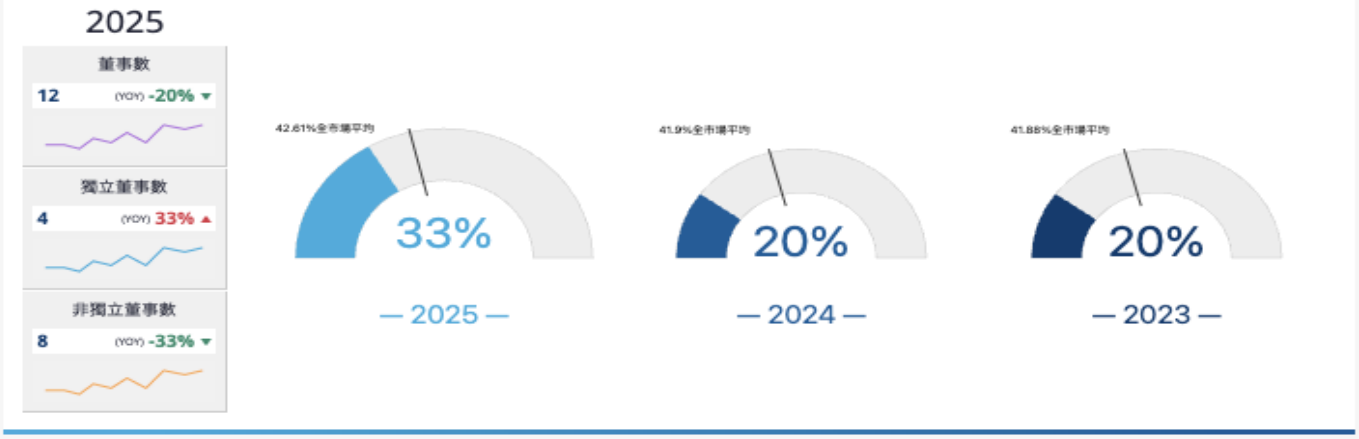
火災件數與死傷人數



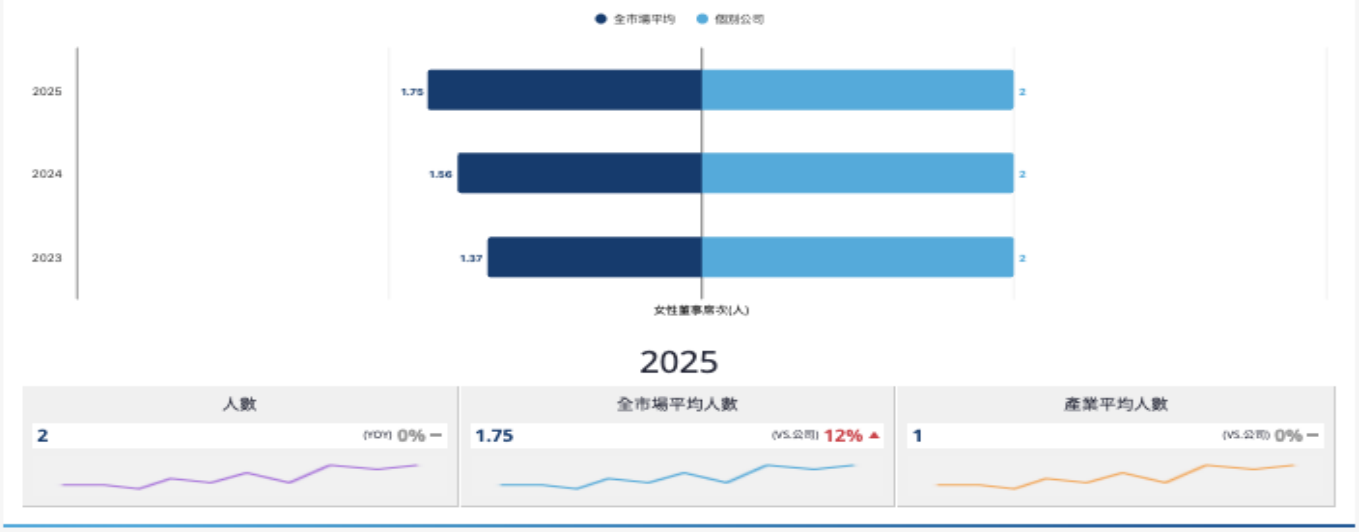
2026/11/06

ESG 資訊—公司治理(Governance)

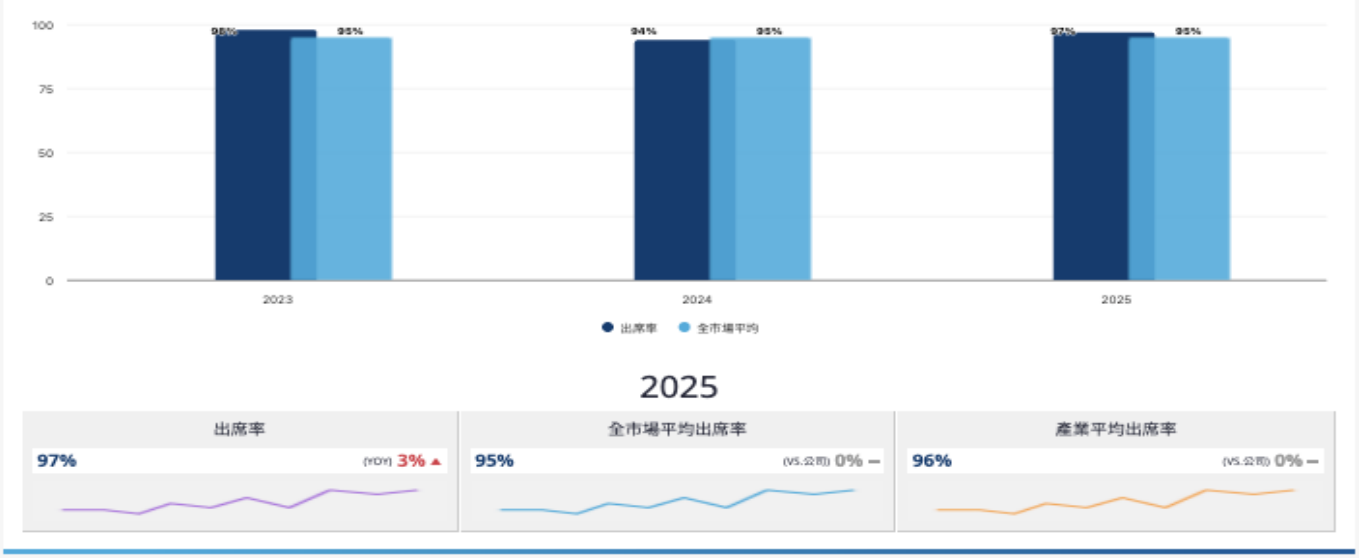
獨立董事vs.董事席次占比



女性董事席次



董事之董事會出席率



2026/11/06

董事進修符合進修要點比率

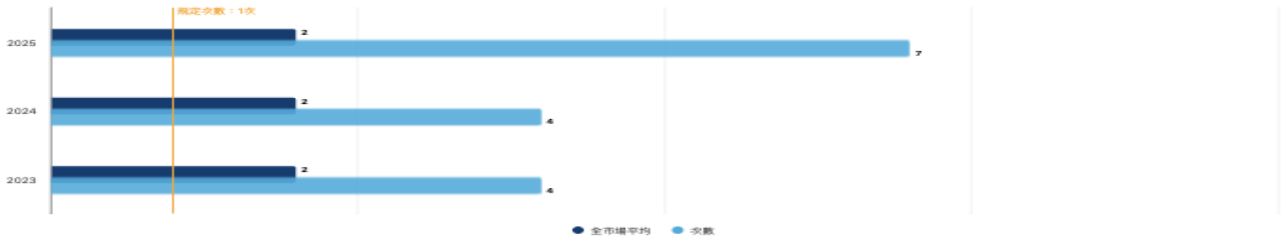


內圈:個別公司　外圈:全市場平均

2025

進修率	全市場平均進修率	產業平均進修率
100% (YOY) 0% —	94% (VS.公司) 1% ▲	95% (VS.公司) 1% ▲

法說會次數



2025

次數	全市場平均次數	產業平均次數
7 (YOY) 75% ▲	2 (VS.公司) 0% —	2 (VS.公司) 0% —

薪酬委員會出席率

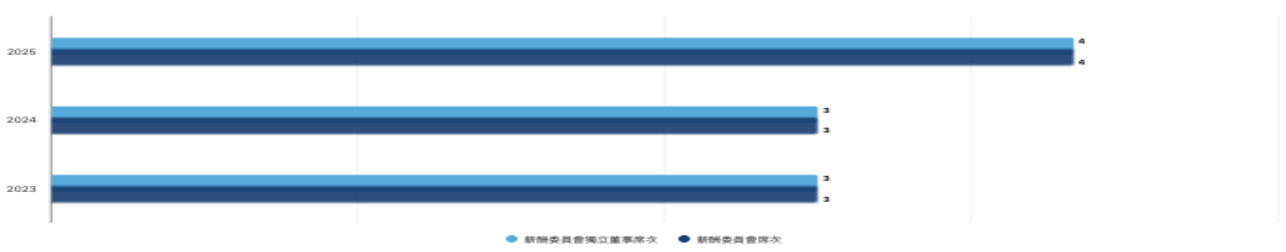


內圈:個別公司出席率　外圈:全市場平均出席率

2025

進修率	全市場平均進修率	產業平均進修率
100% (YOY) 0% —	97% (VS.公司) 1% —	97% (VS.公司) 1% —

薪酬委員會席次



資料來源：證交所

2026/11/06

投資評等說明

個股評等	Rating	定義
買進	Buy (B)	相較於市場指數之回報潛力極具吸引力
增加持股	Overweight (OW)	相較於市場指數之回報潛力略有吸引力
中立	Neutral (N)	相較於市場指數之回報潛力相似
降低持股	Underweight (UW)	相較於市場指數之回報潛力稍低
賣出	Sell (S)	相較於市場指數之回報潛力較低
未評等	Not Rated (NR)	

免責聲明

【中國信託證券投資顧問股份有限公司獨立經營管理】

本報告係本公司於特定日期就現有資訊所提出，雖已力求正確與完整，但因時間及市場客觀因素改變所造成產業、市場或個股之相關條件改變，本公司將不做預告或更新；而且本報告並非依特定投資目的或特定對象之財務狀況所完成，因此，本報告之目的並非針對客戶於買賣證券、選擇權、期貨或其他證券相關商品提供詢價或推介服務，亦非進行交易之要約。本公司出具之短、中、長期策略性報告所做出之投資分析與建議，亦可能會隨市場波動隨時調整，而與個股研究報告之意見未必一致。投資人應自行考量本身之需求、投資風險及承受度，並就投資結果自行負責，本公司不做任何獲利保證，亦不就投資盈虧負擔任何法律責任。非經本公司同意，任何人不得將本報告加以引用或轉載。

中國信託金融控股(股)公司旗下子公司暨關係企業(以下稱"中信金集團")從事廣泛金融業務，包括但不限於銀行、信託、證券經紀、證券承銷、保險、證券投資信託、全權委託投資、自有資金投資等。中信金集團對於本報告所涵蓋之標的公司可能有投資或其他的業務往來關係。中信金集團及其所屬員工，可能會投資本報告所涵蓋之標的公司，或以該等公司為標的的衍生性金融商品，而其交易的方向與本報告中所提及的交易方向可能不一致。中信金集團於法令許可的範圍內，亦有可能以本報告所涵蓋之標的公司作為發行衍生性金融商品之標的。中信金集團轄下的銷售人員、交易員及其他業務人員可能會為他們客戶或自營部門提供口頭或書面的市場看法或交易策略，然該等看法與策略可能與本報告的意見不盡一致。中信金集團之自營、資產管理及其他投資業務所做之投資決策也可能與本報告所做的建議或看法不一致。

中國信託證券投資顧問股份有限公司

台北市南港區經貿二路 188 號 5 樓及 18 樓 / (02) 5569-1988

營業執照字號：114 金管投顧新字第 014 號